

【原因・判断ポイント・発生工程】ワイヤボンディング端子表面に異物（ガラスクロス繊維など）が付着していたことにより出来たもの（回路形成～ワイヤボンディング）

【原因、判断要点、発生工序】在金属丝接合的插脚表面附着杂物（玻璃纤维等）所引起的（图形转移～金属丝接合）。

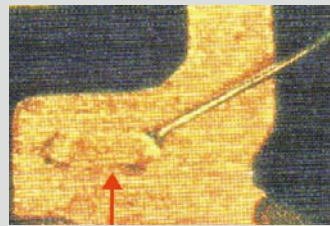
【Causes/processes involved/keys to judgment】
The defect is caused by a foreign object (e.g. glass fiber debris) existing on the surface of a wire bonding terminal area (Conductor formation - wire bonding)



【コメント】
ボンディング部にガラス繊維痕跡あり
顕微鏡倍率×

【注釋】
在接合部有玻璃纤维的痕迹
显微镜倍率 ×

【Comments】
Trace of glass fiber on bonding area
Magnification: ×



【コメント】
ボンディング金表面の微量異物によるもの
顕微鏡倍率× 50

【注釋】
在接合金表面有微量杂物
显微镜倍率 × 50

【Comments】
Caused by fine foreign object on plated gold
Magnification: ×50

7-4-8 プレス滓上がり／冲切渣的堵塞 / Hole plugged with punch debris

【特徴】プレス抜き滓がプレス抜き穴の中に詰まっている状態の欠陥

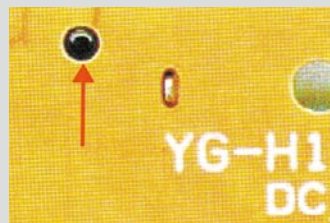
【特征】冲切渣堵塞在冲切孔内的缺陷。

【Characteristics】A punched hole is plugged with punch debris.

【原因・判断ポイント・発生工程】打ち抜きプレス金型の滓抜けが悪い為、抜き滓が金型に詰まり、それが製品の穴の中にまで残されて出来たもの（打ち抜きプレス工程）

【原因、判断要点、発生工序】冲切模具的排渣差，堵塞模具，然后堵塞板的孔所引起的（冲切工序）。

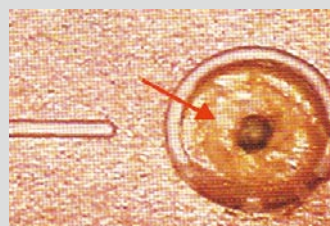
【Causes/processes involved/keys to judgment】
A punched hole is plugged with punch debris because of poor debris removing ability of the punch, and the punch debris remains in a hole. (Blanking/punching process)



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×